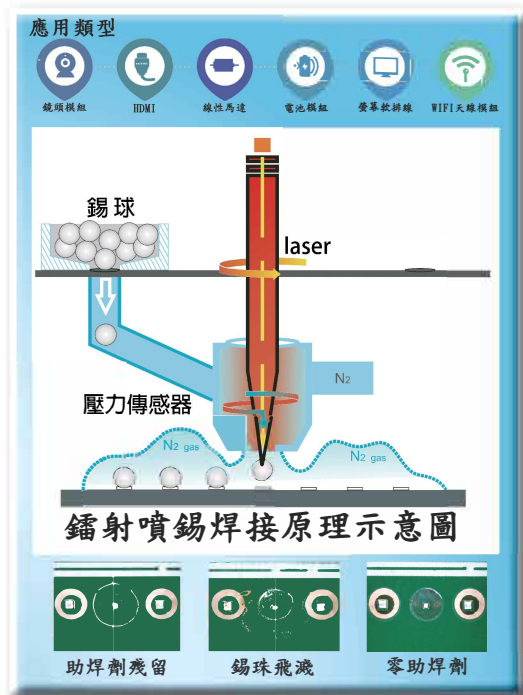
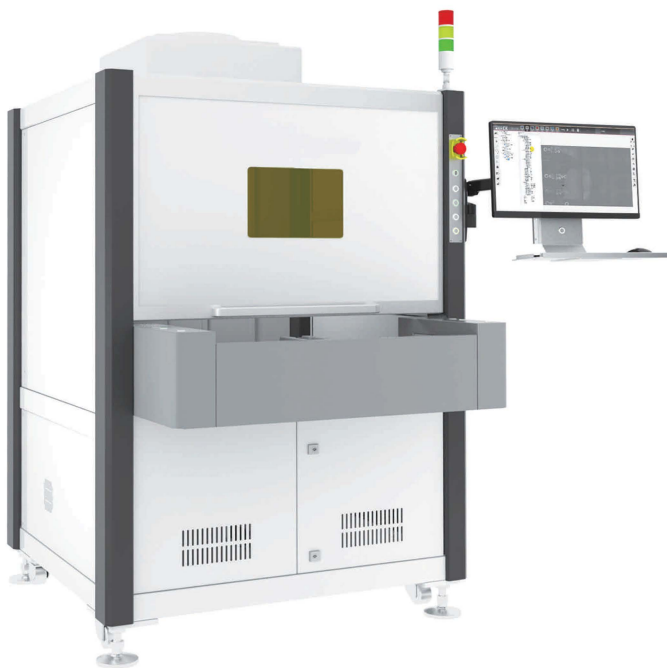




EA-LB100 鐳射激光噴錫微點焊接機



鐳射激光噴錫焊接，為表面黏著元件帶來全新的焊接解決方案，鐳射經由光纖傳輸，通過鐳射的高脈衝能量瞬間熔化至噴嘴上的錫球。環形槍體上設置高壓氮氣入口，利用高壓氮氣壓力，將熔化後的錫料噴射到焊點表面，保證熔化的焊錫不會被氧化。多軸智慧運動控制平台，高精度 CCD 定位、測高、焊點檢測等功能的高精度鐳射噴錫焊接機提供保障。物件導向應用交互的人化、防呆設計，安全防護設計，易於操作安全。

特點

- PC 控制、視覺化操作。高清晰度攝像，自動定位，滿足高精密器件自動加工要求。
- 錫料熔錫噴射至焊盤，避免焊接過程中產生的熱壓力。
- 配備氮氣模組，焊接過程全程保護。
- 無需添加助焊劑，免除二次清洗過程，最大限度保證電子器件壽命。
- 可通過錫球大小的選擇完成不同焊點的焊接。
- 採用錫球自動送料方式，尤其適合對錫量一致性要求極高的物件。
- 雙 Z 軸平台，可同時進行左邊產品運動至光學檢測，完成後運動到焊接位置進行焊接。同時右邊的產品運動至光學對位元，左側焊接和右側光學對位元可同時進行。效率提升 2 倍以上。
- 加熱區域集中，極短的焊接時間，特別適合引腳細、間距小精密微焊接。
- 錫球直徑 $\varnothing 0.2 \sim 0.76\text{mm}$ 。錫球焊接速度 < 5 個 / 秒。

規格

型號	EA-LB100	
輸入電壓	50~60Hz	
整基峰值功率	AC220V	
鐳射波長	2500W	
定位 CCD 圖元	1064nm	
定位光源	500W	
FFU 單元過濾效果	白色 LED 燈環 (24V)	
焊接速度	99.99% @ 0.3um ~ 99.999% @ 0.3um	
治具最大尺寸	3 個 / 秒 (視焊接環境)	
軸動範圍	X1-X2 軸	260mm × 300mm
	Y 軸	0~700mm
	Z1-Z2 軸	0~800mm
軸速速度	X1-X2 軸	0~100mm
	Y 軸	0.1~800mm/sec
	Z1 軸	0.1~800mm/sec
定位精度	XYZ 軸	0.1~600mm/sec
重複精度	XYZ 軸	±0.02mm
控制方式	XYZ 軸	±0.01mm
噪音	主機板 + PC	<70dB(距離 1M 處量測)
晶片尺寸	5 × 5mm ~ 25 × 25mm	
作業範圍	280 × 250mm	
焊接區域尺寸	300 × 250mm	
尺寸 (L × W × H)	1200 × 1500 × 1750mm	
重量	750Kg	

應用類型

